



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D225633 S

(45)公告日：中華民國 112 (2023) 年 06 月 01 日

---

(21)申請案號：110306502

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 11 月 30 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2021/06/28 日本

2021-014030

(71)申請人：日商國際電氣股份有限公司 (日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)  
日本

(72)設計人：岡嶋優作 OKAJIMA, YUSAKU (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D210787

審查人員：朱哲慶

圖式數：9 共 6 頁

---

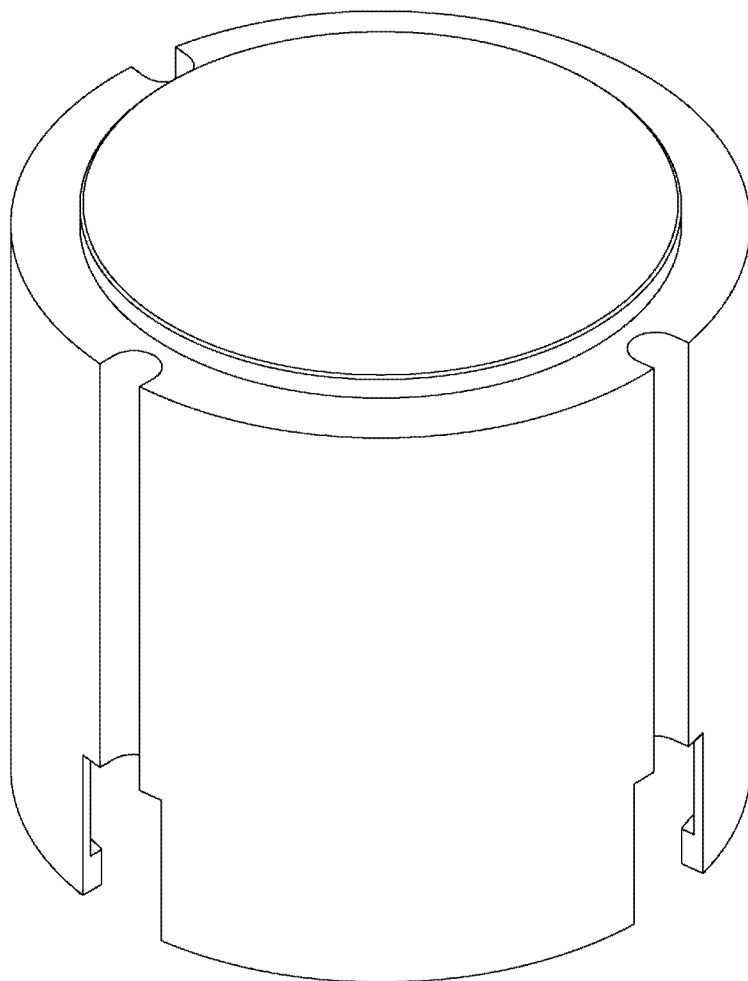
(54)名稱

半導體製造裝置用隔熱組件外罩

代表圖：

D225633

TW D225633 S



【立體圖】



公告本

D225633

## 【設計說明書】

【中文設計名稱】半 導 體 製 造 裝 置 用 隔 熱 組 件 外 罩

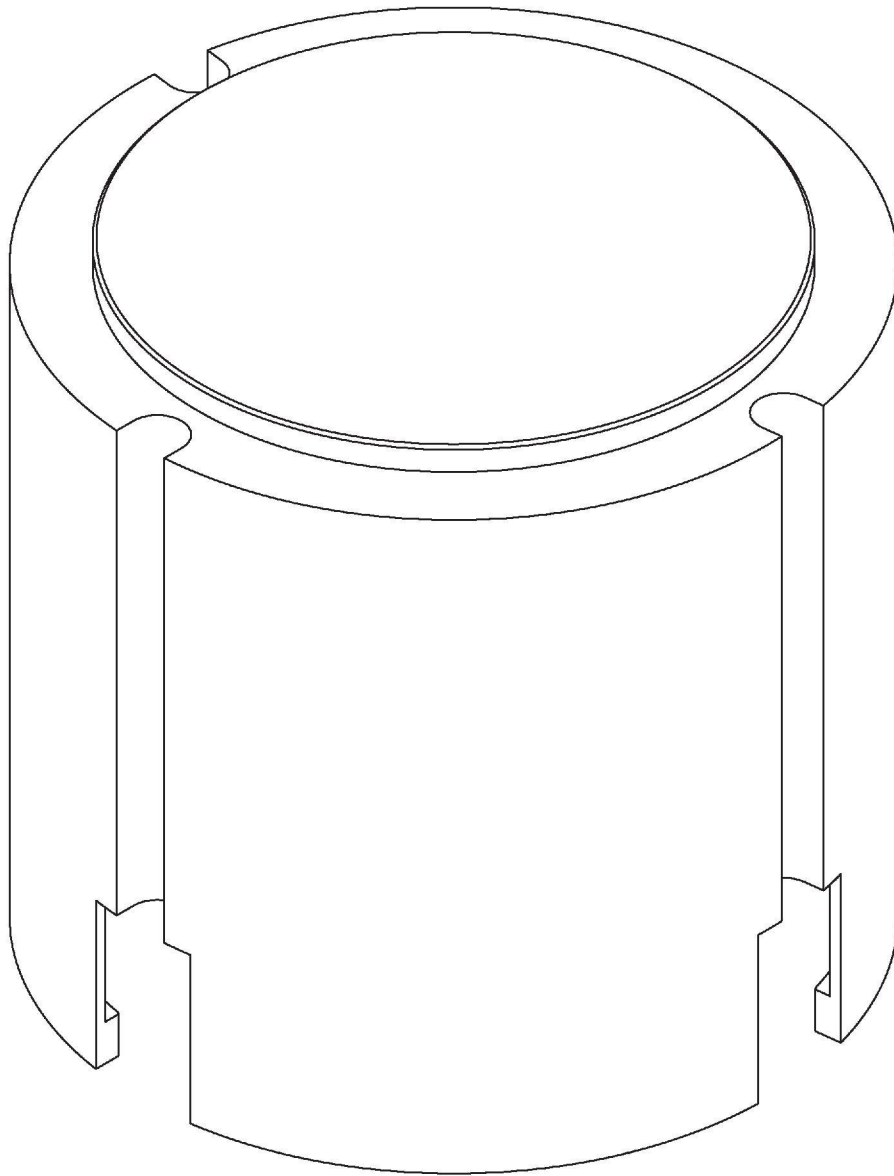
【物品用途】

【0001】本設計的物品是半導體製造裝置用隔熱組件外罩，為用來包覆被設置在處理半導體晶圓等之基板的反應管之爐口部的隔熱組件之外罩。

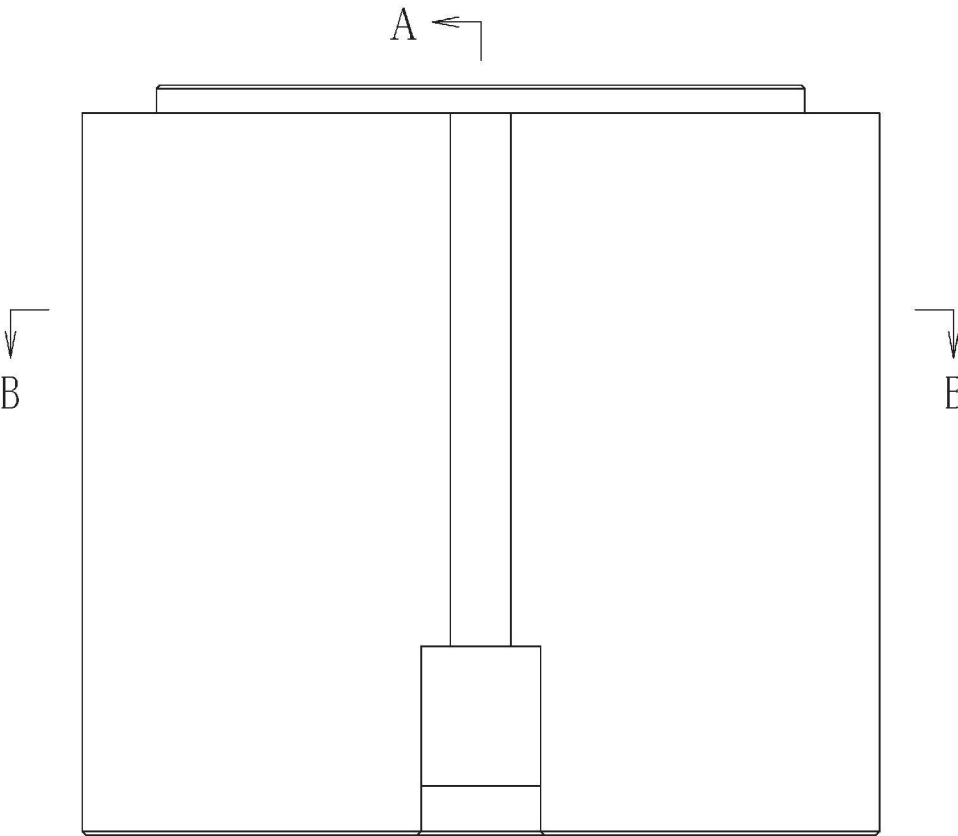
【設計說明】

(無)

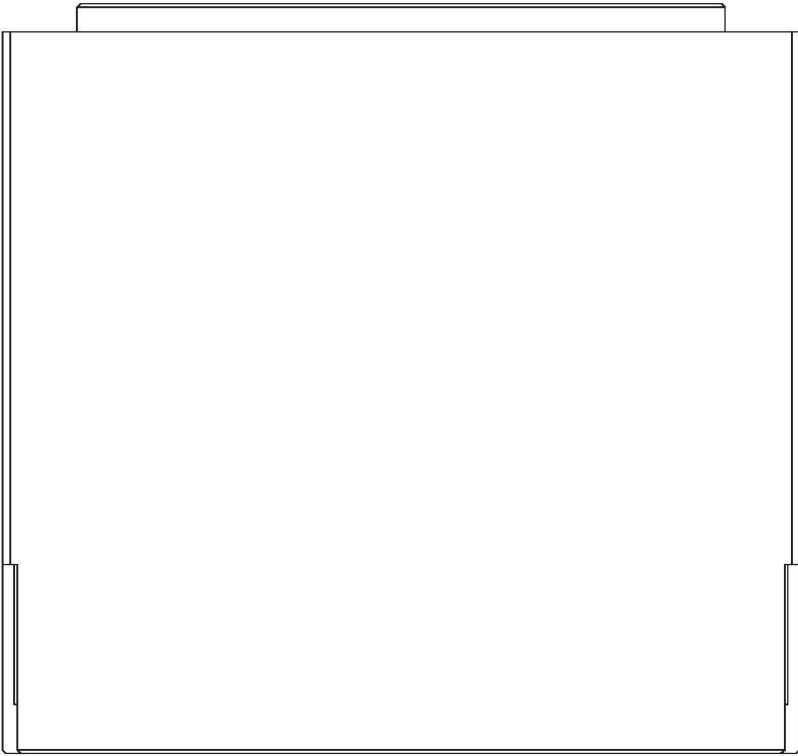
【設計圖式】  
(指定代表圖)



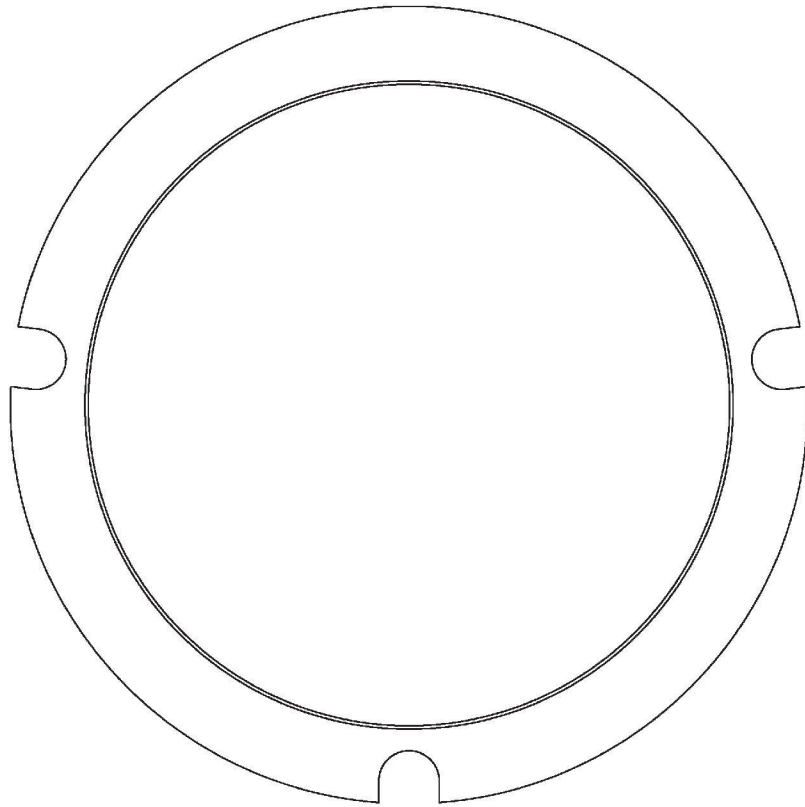
【立體圖】



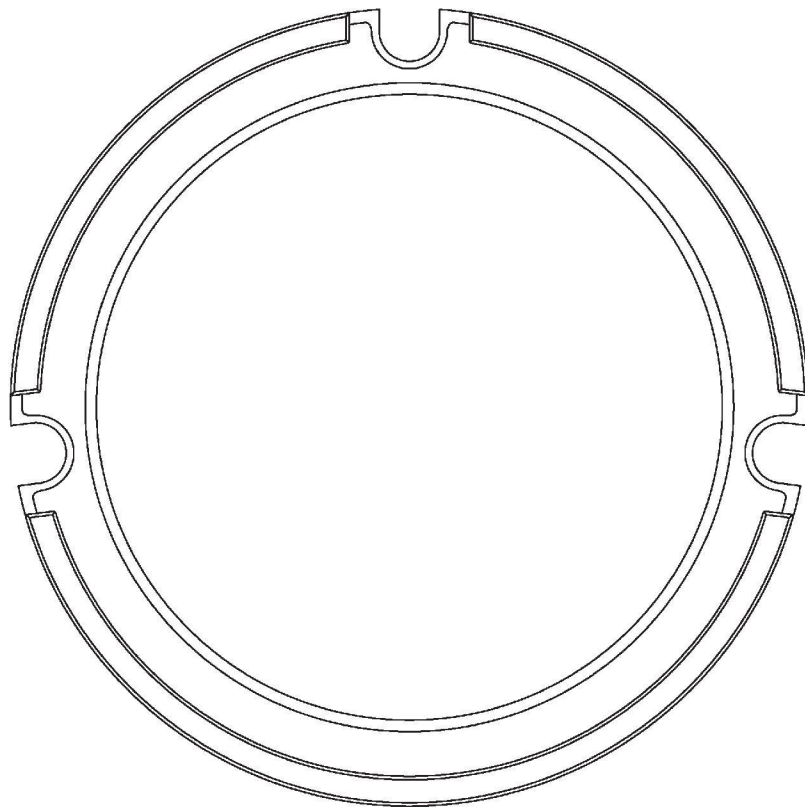
A ←  
【前視圖】



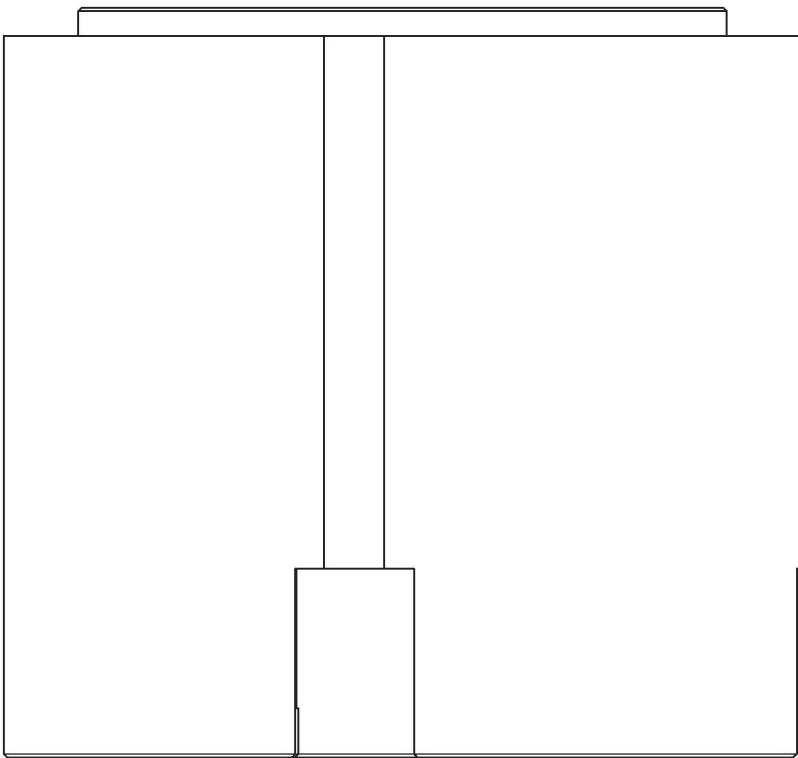
【後視圖】



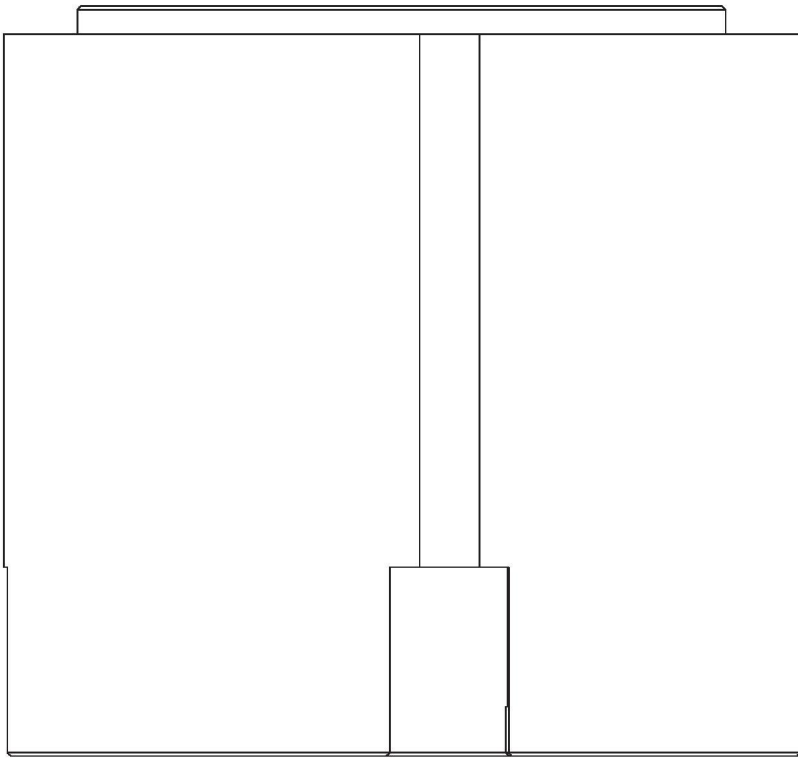
【俯視圖】



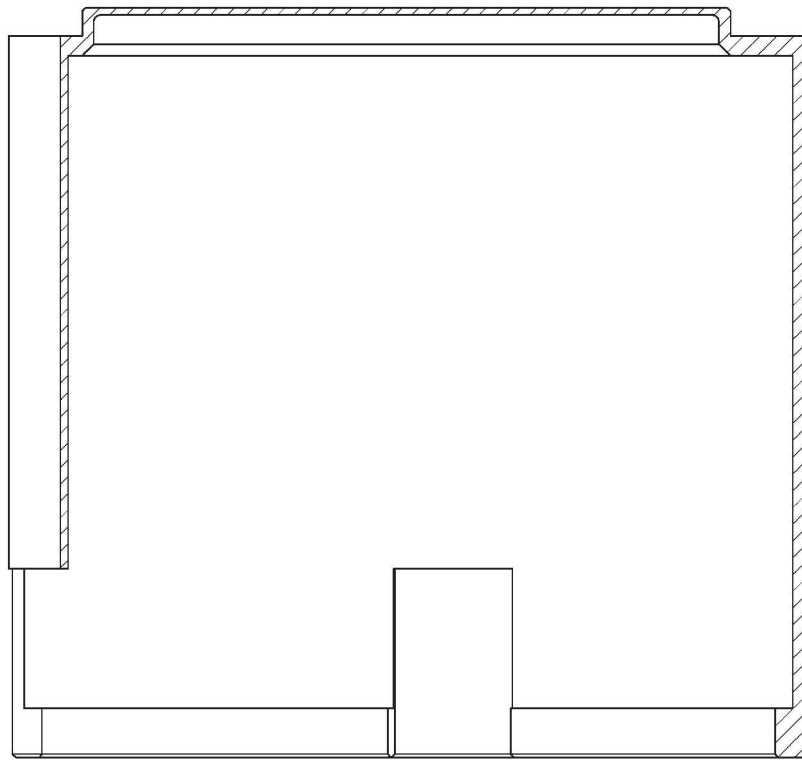
【仰視圖】



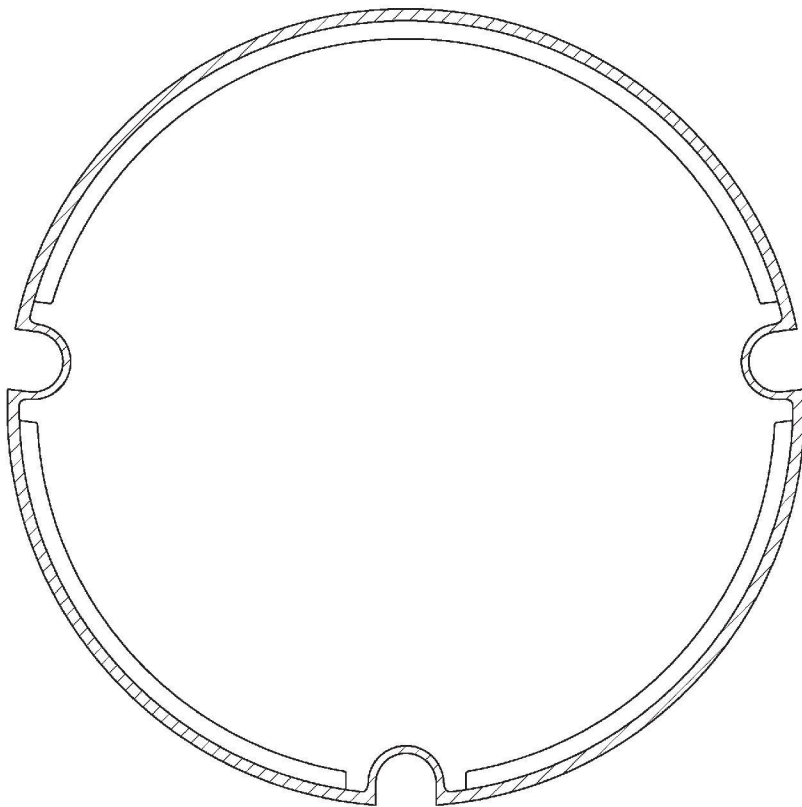
【左側視圖】



【右側視圖】



【A-A剖面圖】



【B-B剖面圖】